



第50期 決算のご報告

2008年4月1日から2009年3月31日まで

BUSINESS REPORT  
JEM TODAY



日本電子材料株式会社

証券コード:6855

## 厳しい環境だからこそ積極的に 経営体質強化に取り組み持続的成長を目指します

### 過去に例を見ない程の需要減退の影響を受けた1年でした

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

2008年度(2008年4月1日～2009年3月31日)の決算概況をご報告させていただきます。

連結業績は売上高108億6千5百万円(前期比23.9%減)、営業損失10億7千8百万円、経常損失11億3千2百万円、当期純損失14億7千6百万円となりました。

半導体デバイスの価格下落に伴い、デバイスメーカーが生産調整や設備投資抑制を行ったため、期初から厳しい状況で推移しました。さらに下期に入ってから、世界経済の減速に伴い、半導体デバイスを搭載する最終製品の需要は過去に例を見ないほど急激に落ち込み、受注は大幅に落ち込みました。ただ、こうした厳しい環境下で、新規案件については、当社製品を採用していただくケースも増えております。競合各社との熾烈な新規受注競争に勝っているということは、足元の売上、利益にすぐに直結するものではありませんが、景気の回復時には、大きな収益につながるものと期待しております。

### 事業環境の激変に対応し、いち早く経営体質強化に取り組みました

当社では、事業環境の急激な変化に対応するため、2009年1月から様々な経営体質強化策を実施しました。①国内製造拠点の統合、②海外拠点の再編、③希望退職者募集等による人員の最適化、④全社的な経費節減、などが主なものです。かなり早い段階に手を打てたため、現在、その成果を把握できる状態になっています。これまで当社の業績は右肩上がりでも推移してきましたので、非効率な点が多々隠れているのではないかと考えています。再度、見直しを図り、徹底的な経営体質強化に取り組んでまいります。2009年度の連結業績につきましては、売上高96億円、営業損失6億8千万円、経常損失7億円、当期純損失7億円を見込んでいます。世界各国で実施されている景気対策の効果も期待されていますが、本格的な回復には時間を要することが見込まれます。上期の段階ではまだ厳しい状況が続くとみっていますが、下期には黒字化を果たしたいと考えています。

## 利益体質への転換、既存製品の競争力強化による売上確保を目指します

2009年度は先程、申し上げた通り、徹底的な経費節減と原価低減を継続し、利益体質への転換を図ります。そして、選択と集中によって設備投資を抑制するとともに、既存製品の競争力強化によって売上の確保を目指します。

製品別では、4月に、先端技術を利用したMタイププローブカード(MEMS型)のフラッシュメモリー向け「MCシリーズ」の受注に成功しましたが、これまで以上にコスト競争が激しく、技術的要求も多様化していますので、性能向上と製品ラインナップ拡充などの競争力強化を図り、着実に育てていきたいと考えています。既存のVタイプは、メモリーIC向け「VS4(垂直スプリング接触型)シリーズ」の徹底的な原価低減によって安定的な売上確保に努めるとともに、「VC(垂直接触型)シリーズ」も、顧客ニーズを地道に捉えながら、市場の掘り起こしを図ります。また、ロジックIC向けは、フリップチップ用に「VS2シリーズ」を拡販するとともに、サンプル出荷を終えた、多数個同時測定用の新シリーズ「VTシリーズ」の早期量産化を目指します。「CE(カンチレバー型)シリーズ」は、今後も市場が急拡大することはありませんが、海外生産工場の抜本的な合理化推進、新しい針材の投入などで競争力の強化を続けてまいります。

## 株主の皆様へ

当社を取り巻く事業環境は厳しい状況が続いております。この苦境を一気に打破するというようなことはお伝えできませんが、全社員が一丸となって、体質の強化と売上の確保に取り組みます。このような厳しい時にこそ、できることがあるはずです。現状の厳しい経営環境を積極的に捉え、1から出直すつもりで1年間取り組めば、大きな力になると考えています。それがやがて土台となり、2010年度には大きな花が開くよう、努力していきたいと考えています。引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。なお、2008年度の配当につきましては1株当たり15円(第2四半期末10円、期末5円)とさせて頂き、2009年度につきましては1株当たり10円(第2四半期末5円、期末5円)を予定しています。

代表取締役社長 坂根 英生



# Innovating Global Success!

## ～グローバル展開へのイノベーション～

半導体デバイスの価格下落に加え、金融危機以降の世界経済急減速に伴い、半導体業界も厳しい経営環境が続いています。当社グループでは昨年度に国内拠点の統合、海外拠点の再編、人員の最適化等の抜本的な経営体質強化策を行ってきました。本年度も厳しい経営環境の継続が見込まれますが、中期経営計画の重点戦略に基づき活動するとともに、激変した経営環境での課題解決に取り組んでまいります。

### 中期重点戦略と経過

#### 1 Mタイプの事業化

- MCシリーズ(フラッシュメモリ向け、300mm一括タイプ)の受注獲得
- MCシリーズ(DRAM向け、300mm一括タイプ)の開発加速

#### 2 既存製品の進化

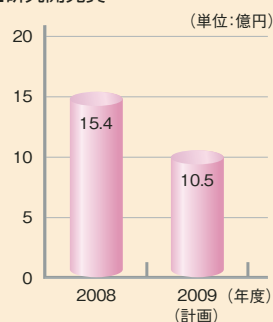
- VTシリーズ(ロジックIC向け、多数個同時測定用)のサンプル出荷完了
- VSシリーズ(フラッシュメモリ向け)の売上堅持

#### 3 顧客満足度の向上

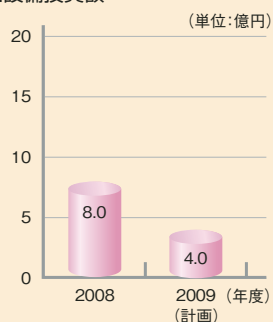
- 工程の見直しによる短納期化推進
- 顧客ニーズに応じた製品開発の継続

現在の経営環境を乗り切るため、選択と集中により投資を抑制するとともに、徹底的な経費削減と原価低減を図ります。

■研究開発費



■設備投資額



### Mタイプとは

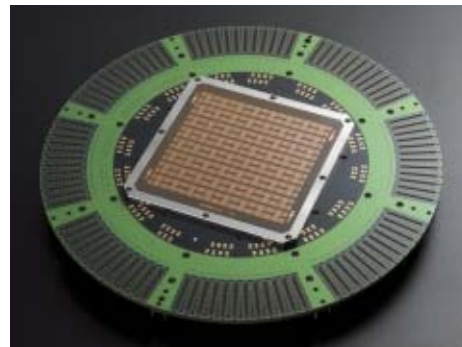
プローブカードには微細化、大口径化、低針圧化など多くの技術課題があります。従来のプローブカードは金属を針状に加工したプローブ(針)を手作業で並べて製作していましたが、MタイプはMEMS技術を応用してプローブを製作。品質の向上と共に、従来の技術では不可能なレベルのプローブカードの製作が可能になります。

★MEMS技術…半導体製造工程などで用いられる写真製版技術等を応用した技術

## TOPIC 1

## Mタイプの近況

中期経営計画の重点戦略「Mタイプの事業化」につきましては、フラッシュメモリー向けMCシリーズを受注いたしました。このMCシリーズは市場規模の大きいメモリーIC向けであり、戦略製品として大きな役割を担う製品です。しかしながら、現在の事業環境下では、更なるコスト競争力の強化や性能向上が必要不可欠となっています。このため、MCシリーズのブラッシュアップを行い製品競争力の強化を図るとともに、Mタイプの主要市場であるDRAM向け市場への参入を目指します。



## TOPIC 2

## 2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日)の業績予想

世界各国で行われている景気対策の効果も期待されていますが、本格的な景気回復には時間を要し、本年度も厳しい事業環境が継続することが見込まれています。

このような状況下で当社グループは、Vタイプの売上確保と拡販、Mタイプの競争力強化を行うとともに、投資の選択と集中、生産体制の再構築等を行い、持続的成長のための経営基盤強化に全力で取り組んでまいります。

## ■連結業績予想

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
第2四半期	3,900	△680	△700	△700
通期	9,600	△680	△700	△700

## ■個別業績予想

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
第2四半期	3,600	△600	△600	△370
通期	8,700	△600	△600	△370

## プローブカード

# 半導体製造に欠かすことができない 当社の主力製品「プローブカード」

### プローブカードとは？

携帯音楽プレーヤー、携帯電話、薄型テレビやデジタルカメラなど、様々な分野の製品に応用が拡大されている半導体。この半導体の検査に欠かせないのが、当社の主力製品「プローブカード」です。

当社は1970年、このプローブカードの製造を日本で初めて開始。国内をはじめアジア、アメリカ、ヨーロッパの市場に製品を供給しています。プローブカードは、テストする半導体の仕様に合わせて個別に設計、製造される特注品。そのため、半導体のモデルチェンジの都度、それに応じたプローブカードが新規に製造されます。

Cタイプ(カンチレバー型)



Vタイプ(垂直型)



VSシリーズ  
(垂直スプリング接触型)



### プローブカードの活躍場所 ～ウエハテスト～

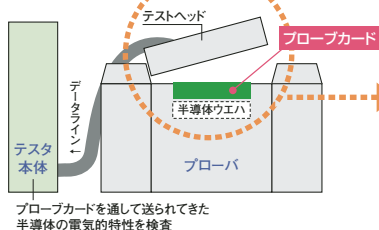
#### ■半導体の良品・不良品を判別

プローブカードは半導体の良品・不良品を判別するテスト工程で使用されます。これはシリコンウエハ上に作られた多数の半導体チップの一個一個が正しく作動するかどうかを調べるテストであり、これを『ウエハテスト』と呼びます。

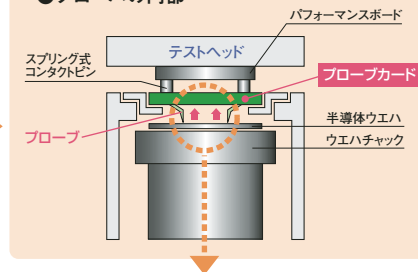
#### ■ウエハテストの流れ

テストからの電気信号をウエハ上の半導体チップの電極(ボンディングパッド)に接触しているプローブカードのプローブ(針)を通して、電気的検査を実施。ウエハ上の半導体すべての良否を判別します。

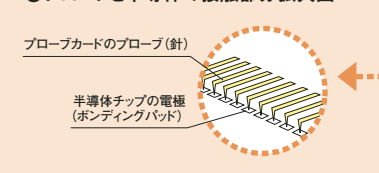
#### ●ウエハテストの仕組み



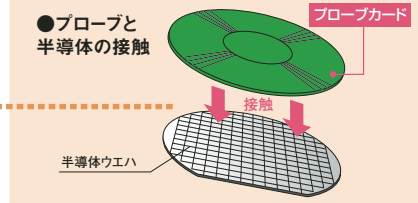
#### ●プローバの内部



#### ●プローブと半導体の接触部分拡大図



#### ●プローブと半導体の接触



## 電子管部品

# 創業以来愛され続けるJEMの電子管部品

当社は1960年の創業以来、受信管、ブラウン管用ヒーターやカソード、フィラメントなどの製造をしてきました。ブラウン管用のヒーターは時代の流れと共に終息しましたが、その技術をもとに、各種陰極・フィラメントの他、産業用・理化学用電子機器の電子銃組立てなどの顧客ニーズに対応しています。

## ネットワーク

### 世界に広がる生産・販売拠点と研究開発のグローバルイゼーション

エレクトロニクス産業の国際化に対応して、JEMでは先駆的に海外に生産・販売拠点を設けてきました。顧客に近接することにより顧客ニーズに即応することと、コスト競争力を実現するためのグローバルロジスティクスがこの背景です。JEMは、アメリカ・中国・台湾・韓国・ヨーロッパに生産・販売拠点を持ち、グローバルサポートを強力に推進しています。



## 業績の推移(連結)

(単位:億円)

期 別	2006年度	2007年度	2008年度
売 上 高	162.1	142.7	108.6
営 業 利 益	28.3	11.4	△ 10.7
経 常 利 益	28.4	12.1	△ 11.3
当 期 純 利 益	17.6	3.4	△ 14.7
1株当たり当期純利益(円)	166.70	32.56	△ 139.40
総 資 産	170.2	168.6	172.7
純 資 産	124.0	122.8	99.8
1株当たり純資産(円)	1,171.81	1,159.69	943.27

※記載金額未満は切り捨てて表示しております。

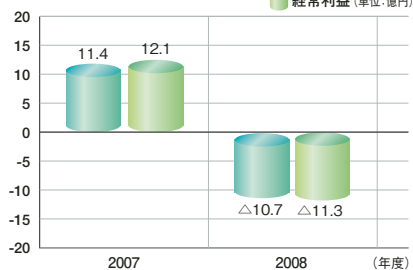
### 売上高

(単位:億円)



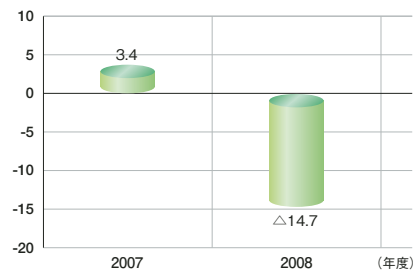
### 営業利益・経常利益

■ 営業利益  
■ 経常利益 (単位:億円)



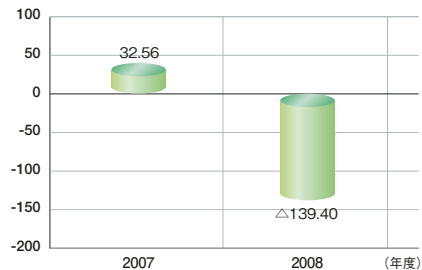
### 当期純利益

(単位:億円)



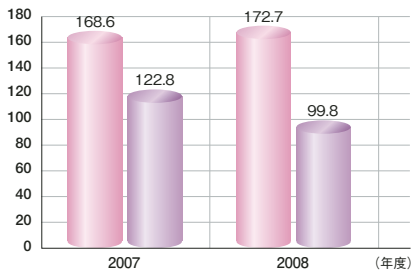
### 1株当たり当期純利益

(単位:円)



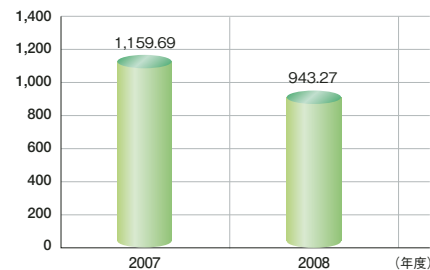
### 総資産・純資産

■ 総資産 ■ 純資産 (単位:億円)



### 1株当たり純資産

(単位:円)





# 財務諸表(連結)

## 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度 (2008年3月31日現在)	当連結会計年度 (2009年3月31日現在)
<b>[資産の部]</b>		
<b>流動資産</b>	<b>11,625</b>	<b>12,812</b>
現金及び預金	4,410	3,347
受取手形及び売掛金	5,584	3,327
有価証券	224	4,473
たな卸資産	1,171	-
商品及び製品	-	99
仕掛品	-	248
原材料及び貯蔵品	-	590
繰延税金資産	80	70
その他	160	661
貸倒引当金	△ 6	△ 6
<b>固定資産</b>	<b>5,238</b>	<b>4,465</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,696</b>	<b>3,196</b>
建物及び構築物	612	565
機械装置及び運搬具	1,252	1,054
工具器具及び備品	1,138	817
土地	455	455
リース資産	-	229
建設仮勘定	237	73
<b>無形固定資産</b>	<b>371</b>	<b>355</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,170</b>	<b>913</b>
投資有価証券	919	627
その他	252	287
貸倒引当金	△ 0	△ 0
<b>資産合計</b>	<b>16,864</b>	<b>17,278</b>

科 目	前連結会計年度 (2008年3月31日現在)	当連結会計年度 (2009年3月31日現在)
<b>[負債の部]</b>		
<b>流動負債</b>	<b>3,981</b>	<b>6,183</b>
支払手形及び買掛金	2,295	1,120
短期借入金	150	3,500
リース債務	-	34
未払金	434	936
未払法人税等	254	-
賞与引当金	5	7
未払費用	269	171
1年内返済予定の長期借入金	-	99
その他	573	313
<b>固定負債</b>	<b>601</b>	<b>1,106</b>
長期借入金	-	392
リース債務	-	232
繰延税金負債	151	3
役員退職慰労引当金	449	465
その他	0	12
<b>負債合計</b>	<b>4,582</b>	<b>7,289</b>
<b>[純資産の部]</b>		
<b>株主資本</b>	<b>12,293</b>	<b>10,605</b>
資本金	983	983
資本剰余金	1,202	1,202
利益剰余金	10,122	8,434
自己株式	△ 14	△ 15
<b>評価・換算差額等</b>	<b>△ 12</b>	<b>△ 616</b>
その他有価証券評価差額金	△ 0	△ 19
為替換算調整勘定	△ 11	△ 596
<b>純資産合計</b>	<b>12,281</b>	<b>9,989</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>16,864</b>	<b>17,278</b>

### ポイント

#### ■売上・収益動向

上期までは、フラッシュメモリー向けを中心にVタイプブロープカードの拡販に努めることにより数量需要を取り込みましたが、下期に入ってからの世界経済の減速に伴い、ほとんどの半導体デバイス需要が急減したこと等により売上が減少し、厳しい状況で推移しました。当社グループでは経営環境の激変に対応するため、様々な経営体質強化へ向けた施策を行ってきましたが、急激な半導体デバイス需要の減少に伴う売上減少の影響が非常に大きく、売上、利益ともに厳しい業績となりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は108億6千5百万円(前連結会計年度比23.9%減)、営業損失10億7千8百万円(前連結会計年度営業利益11億4千2百万円)、経常損失は11億3千2百万円(前連結会計年度経常利益12億1千1百万円)、当期純損失は14億7千6百万円(前連結会計年度当期純利益3億4千4百万円)となりました。

#### ■財務動向

■資産・負債・純資産 / 資産は、172億7千8百万円(前連結会計年度末比4億1千4百万円増)となりました。これは、現金及び預金が10億6千2百万円、受取手形及び売掛金が22億5千7百万円、有形固定資産が5億円減少しましたが、有価証券が42億4千8百万円増加したことなどによります。負債は、72億8千9百万円(前連結会計年度末比27億6百万円増)となりました。これは、支払手形及び買掛金が11億7千4百万円減少しましたが、短期借入金が33億5千万円、未払金が5億1百万円増加したことなどによります。純資産は、99億8千9百万円(前連結会計年度末比22億9千2百万円減)となりました。これは、利益剰余金が16億8千8百万円、為替換算調整勘定が5億8千4百万円減少したことなどによります。

■キャッシュ・フローの状況 / 当連結会計年度における現金及び現金同等物は29億2千2百万円増加し、当連結会計年度末は71億7千9百万円となりました。

# 財務諸表(連結)

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度 (自2007年4月1日 至2008年3月31日)	当連結会計年度 (自2008年4月1日 至2009年3月31日)
売上高	14,276	10,865
売上原価	9,576	8,349
売上総利益	4,700	2,516
販売費及び一般管理費	3,558	3,594
営業利益又は営業損失(△)	1,142	△ 1,078
営業外収益	122	90
営業外費用	52	143
経常利益又は経常損失(△)	1,211	△ 1,132
特別利益	64	-
特別損失	156	541
税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△)	1,120	△ 1,674
法人税、住民税及び事業税	668	108
法人税等還付税額	-	△ 97
法人税等調整額	116	△ 208
少数株主損失(△)	△ 10	-
当期純利益又は当期純損失(△)	344	△ 1,476

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度 (自2007年4月1日 至2008年3月31日)	当連結会計年度 (自2008年4月1日 至2009年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,557	346
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,400	△ 936
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306	3,621
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 28	△ 107
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 178	2,922
現金及び現金同等物の期首残高	4,435	4,257
現金及び現金同等物の期末残高	4,257	7,179

## 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自 2008年4月1日 至 2009年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
2008年3月31日残高	983	1,202	10,122	△ 14	12,293	△ 0	△ 11	△ 12	12,281
連結会計年度中の変動額									
剰余金の配当			△ 211		△ 211				△ 211
当期純損失(△)			△ 1,476		△ 1,476				△ 1,476
自己株式の取得				△ 0	△ 0				△ 0
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)						△ 19	△ 584	△ 603	△ 603
連結会計年度中の変動額合計	-	-	△ 1,688	△ 0	△ 1,688	△ 19	△ 584	△ 603	△ 2,292
2009年3月31日残高	983	1,202	8,434	△ 15	10,605	△ 19	△ 596	△ 616	9,989

# 株式の状況・会社概要

## 株式事項(2009年3月31日現在)

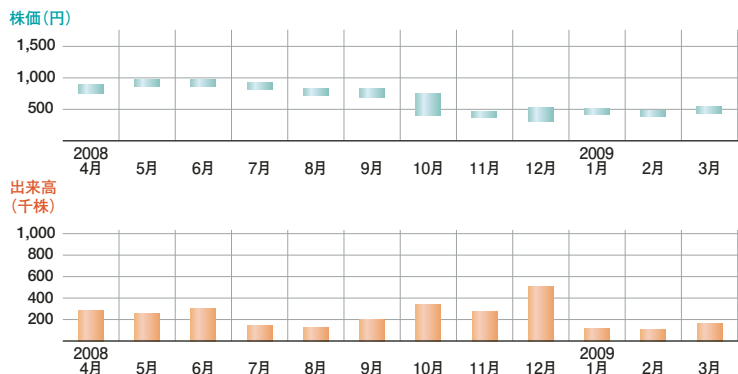
- 発行可能株式総数 40,000,000株
- 発行済株式の総数 10,604,880株
- 株主数 5,883名

## 大株主(2009年3月31日現在)

株主名	持株数 (千株)	出資比率(%)
(有)大久保興産	1,131	10.68
ユービーオーシー ユー. エス. エイ.	649	6.13
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	526	4.97
大久保昌男	500	4.72
大久保和正	435	4.11
大久保英正	406	3.83
(株)三菱東京UFJ銀行	343	3.24
古山陽一	274	2.59
日本マスタートラスト信託銀行(株)	233	2.20
日本電子材料社員持株会	176	1.66

(注)出資比率は、自己株式(15,011株)を控除して計算しております。

## 株価チャート



## 会社概要

社名 日本電子材料株式会社  
 英訳名 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION  
 住所 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号  
 TEL.06-6482-2007(代表)  
 設立 1960年4月6日  
 資本金 983,100千円  
 事業内容 半導体検査用部品

- Cタイププローブカード  
 プローブ(針)の形状が力学でいう片持ち梁(cantilever)の構造を持つタイプです。  
 ・CEシリーズ
- Vタイププローブカード  
 プローブ(針)の形状が垂直型で主として半導体の高集積化・高速化対応として使用されているタイプです。  
 ・VCシリーズ(垂直接触型)  
 ・VSシリーズ(垂直スプリング接触型)
- Mタイププローブカード  
 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術を用いたプローブを使用しているタイプです。  
 電子管部品  
 ■各種陰極、フィラメント等

株式市場 東京証券取引所市場第1部  
 証券コード 6855

## 役員(2009年6月25日現在)

取締役会長	大久保 昌 男
代表取締役社長	坂 根 英 生
代表取締役副社長	大久保 和 正
取締役	古 崎 新 一 郎
取締役	大 澤 茂 巳
取締役	足 立 安 孝
常勤監査役	幸 王 泰 久
監査役	田 村 耕 一
監査役	濱 田 幸 和

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中
基準日	定時株主総会 … 3月31日 (その他必要があるときはあらかじめ公告いたします。) 剰余金の配当 … 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒530-0004 大阪市北区堂島浜一丁目1番5号 電話 ☎ 0120-094-777 (通話料無料) ホームページ <a href="http://www.tr.mufg.jp/daikou/">http://www.tr.mufg.jp/daikou/</a>
公告方法	日本経済新聞に掲載して行います。

- (注) 1. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求、その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等へお問合せ下さい。
2. 特別口座に登録された株式に関するお手続きにつきましては、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
3. 株式事務に関する一般的なお問合せ、未受領の配当金に関するご照会などは三菱UFJ信託銀行にお問合せ下さい。

 **日本電子材料株式会社**

<http://www.jem-net.co.jp>

